

2024中国国际电子材料展览会(深圳)

产品名称	2024中国国际电子材料展览会(深圳)
公司名称	FCE展览
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国
联系电话	15989233176

产品详情

2024深圳国际电子材料展览会

2024 Shenzhen International Electronic Materials Expo

时间：2024年4月9-11日

地点：深圳国际会展中心(宝安馆)

展位预定：徐妍（手机号看联系栏）

指导单位

工业和信息化部

深圳市人民政府

主办单位

赛艾特会展(深圳)有限公司

中国电子器材有限公司

中电会展与信息传播有限公司

深圳市博远国际展览有限公司

组织单位

广州一流展览服务有限公司

展会介绍

电子材料是新一代信息技术产业发展的核心，是支撑经济社会发展的战略性、基础性、先导性的产业。具有产品种类多、技术门槛高、更新换代快、强等特点，广泛应用于新型显示、集成电路、太阳能光伏、电子电路板、电子元器件及电子整机、系统产品等领域，其质量和水平直接决定了元器件和整机产品的性能。作为大湾区核心引擎城市的深圳，是全球重要的电子信息产业基地，正引领带动打造电子信息产业集群，为深圳国际电子材料展览会的举办提供了强大的产业基础和市场支撑。

为进一步提升电子材料行业发展，充分展示电子材料行业的前沿装备技术，积极推动电子材料业界的交流互动，强化电子材料行业的合作意识，实现相互促进、共同发展，2024深圳国际电子材料展览会将于2024年4月9-11日在深圳国际会展中心(宝安馆)盛大举办，展会隶属于第十二届中国电子信息博览会专题展之一，专注于为电子材料企业品牌推广、产品展示、交流合作提供一站式解决方案平台，助力企业实现全产业链的交流和互通。作为兼具规模和影响力的电子材料产业品牌盛会，展会遵循市场发展趋势，给电子材料行业创造提升品牌度和开拓市场的一个契机。充分发挥其传递市场信息与交流先进技术的窗口作用，把握行业发展方向。共享国际化大平台，共拓电子材料大市场，让我们携手同行，共创商机！

展品范围

半导体材料：多晶硅、单晶硅、硅晶圆抛光片、外延片、锗硅材料、SOI材料、太阳能电池用硅材料及化合物半导体材料等；

光电子材料：激光晶体、LD用材料、LED生产用原材料、平板显示(LCD、OLED)相关材料、光纤预制棒及相关材料、新型非线性光学材料等；

微电子封装材料：环氧膜塑封料、引线框架及铜带、键合金丝、环氧导电胶、焊锡球、聚酰亚胺树脂、BGA/CSP多层有机基板、环氧底灌料等；

新型电子元器件用材料：磁性材料、电子陶瓷材料、压电晶体材料、绿色电池用材料、信息传感材料等；

PCB用基材料及辅助材料：覆铜板、电解铜箔、玻纤布、环氧树脂、FPC材料等；

电子精细化工材料：集成电路用高纯化学试剂、电子特气、光刻胶及附属产品、CMP抛光液、电子浆料、抗蚀剂、清洗剂等；

电子专用金属材料：贵金属材料、难熔金属材料、电子锡焊料、稀有金属材料等；

其它：制造工艺、分析与检测仪器、生产加工制造设备等。

展会优势

高效供需对接平台——超10,000+的全产业链电子材料行业相关观众将赴展会现场与国内外品牌实现对接。

同期展会——CITE 2024第十二届中国电子信息博览会是展示全球电子信息产业新产品和技术的平台，经过十一年努力，现已经成为亚洲规模大、产业链全、活动内容丰富、影响力提升快的电子信息展览会，也是行业具有国际影响力的电子信息行业年度盛会。

全媒体渠道曝光——包含百度、360搜索、神马搜索、搜狗搜索四大搜索引擎，微信公众号、微博、搜狐、头条等自媒体平台，DOUYIN、微信视频号、腾讯、爱奇艺等视频资源全媒体主要平台推广曝光，为品牌提高度，加速品牌从同行中脱颖而出。

展会亮点

科技协同创新：发挥粤港澳大湾区城市群效应，为产业链打造创新升级环境，实现从“世界工厂”向“广东创造”转变，建设成新一代电子材料产业集群；实现科技与产业经济与地域经济的相促进。

发掘产业趋势，共铸市场先机：把握电子材料产业协同创新要求高、产值体量大、涉及范围广等特点，积极贯彻落实“逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”，促进中国企业与“一带一路沿线”和发展中国家进行高效的产品流通和输出、共享优势产能，共谋合作发展。

集合消费电子科技产品：汇聚海内外电子材料产业中高新技术企业及各类高新技术产品集中展示，为各方创造项目合作、品牌建设、技术引导及投融资对接机会。

营造科技应用场景体验，引爆新传播潮流：突破传统展览闭环，导入市场新传播矩阵，沉浸式观展体验，同期热点营造话题。

欢迎业界同仁踊跃报名参展CITE-ELE

2024，现正接受申请，请速与我们联系，索取参展合同及展位平面图！

知识科普：

单晶硅制备，需要实现从多晶到单晶的转变，即原子由液相的随机排列直接转变为有序阵列，由不对称结构转变为对称结构。这种转变不是整体效应，而是通过固液界面的移动逐渐完成的，为实现上述转化过程，多晶硅就要经过固态硅到熔融态硅，再到固态晶体硅的转变，这就是从熔融硅中生长单晶硅所要遵循的途径。目前应用广泛的有两种，坩埚直拉法和无坩埚悬浮区熔法，这两种方法得到的单晶硅分别称为CZ硅和FZ硅。